DB HiTek

World Leader In Specialty Foundry

DB HiTek

Contents

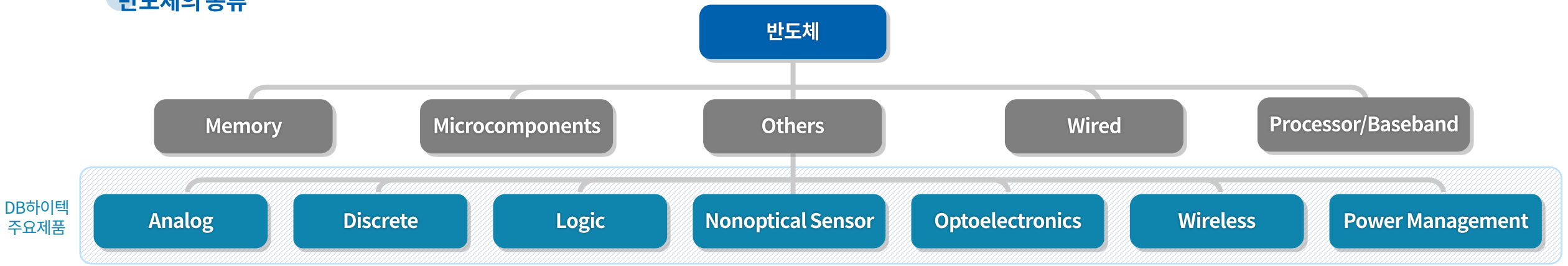
DB HiTek

01

반도체 산업소개 · 시장전망

반도체 산업개요

반도체의 종류



※ (Source) Gartner

시스템반도체

연산 처리 등 시스템 제어·운용을 담당하며 IT기기의 두뇌 역할을 하는 반도체

(ex. 컴퓨터의 CPU, 휴대폰의 모뎀칩, 각종 IT기기의 프로세서)

아날로그반도체란

아날로그 신호

빛,소리,압력, 온도 등 사람이 인식할 수 있는 자연계의 신호

디지털 신호

컴퓨터가 인식할수 있는 전자 신호

반도체 사업형태

종합반도체회사 (IDM)

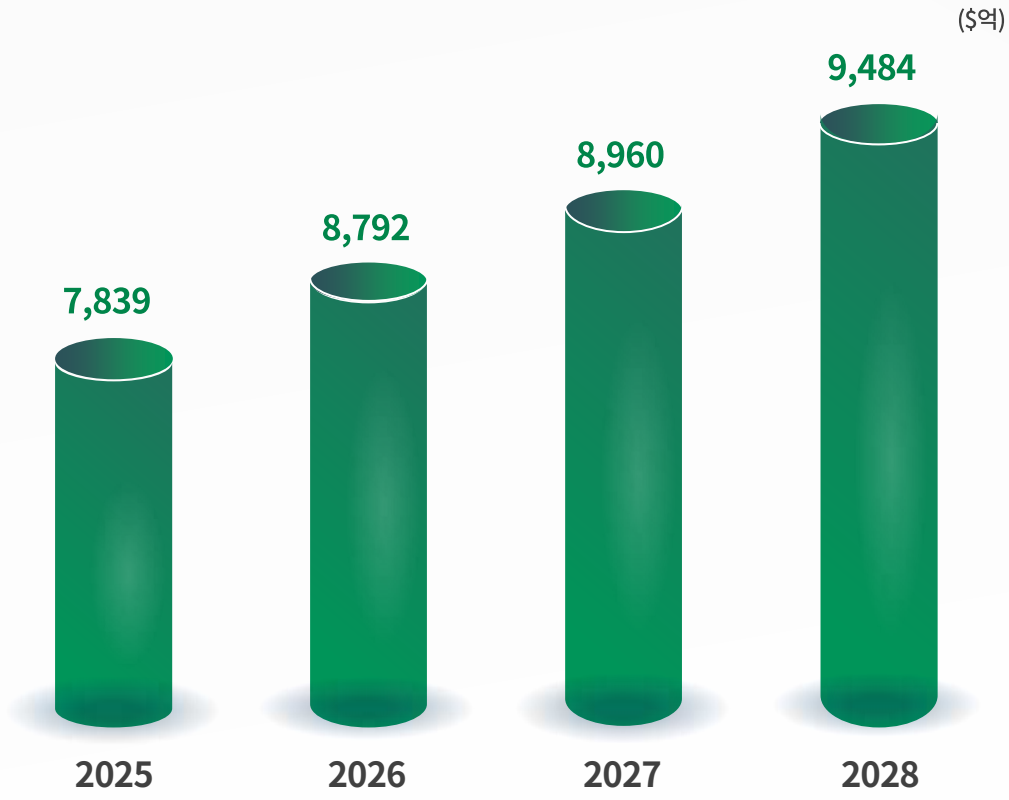
Fabless (설계)

Foundry (웨이퍼 가공)

후공정 (테스트/ 패키지)

구분	IDM	Fabless	Foundry	후공정
수행기능	반도체 설계, 생산, 조립, 판매까지 전부문 수행	반도체 설계담당, Foundry에 외주 생산	시스템반도체 중심으로 웨이퍼 가공만을 전문수행	IDM, Foundry가 생산한 웨이퍼를 완제품으로 가공
사업특성	반도체 전 부문에서 대규모 경영자원 필요	소규모 투자로 반도체 개발, 공급	경영자원의 선택과 집중으로 효율적 경영운영 가능	반도체 후공정으로 제조비용 절감 중요
대표업체	Intel, TI, 삼성, SK하이닉스, Micron	퀄컴, 브로드컴, 미디어텍, LX세미콘, **DB글로벌칩**	TSMC, UMC, SMIC, **DB하이텍**	ASE, Amkor, 네패스

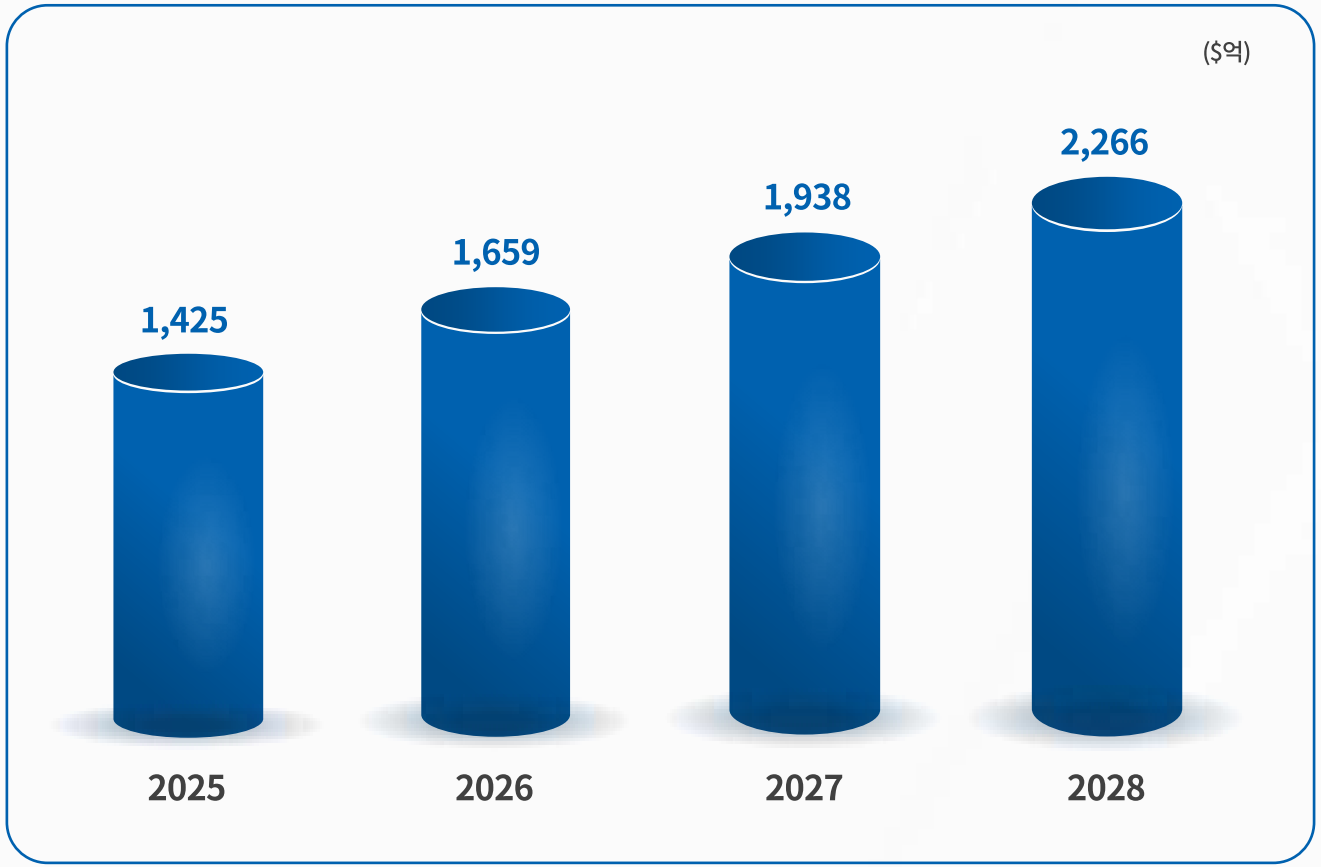
글로벌 반도체 시장



2025년~2028년, 반도체 시장 연평균 7% 성장

※ (Source) Omdia

파운드리 시장



2025년, 파운드리 시장 18% 성장 전망

2025년~2028년, 파운드리 시장
연평균 성장률 17%

※ (Source) Omdia

02

DBH Overview

Dream Big, DB그룹

설립	1969년
매출액	23조원(2023년)
임직원 수	12,000명
계열회사 수	25개
사업 분야	3분야

보험

- DB손해보험
- DB생명

금융

- DB증권
- DB자산운용
- DB저축은행
- DB캐피탈

제조서비스

- DB하이텍
- DB글로벌칩
- DB월드
- DB Inc.
- DB 메탈
- DB커뮤니케이션즈

※ (Source) 공정위, '24년

회사 개요

"우리는 비메모리업에 헌신하여 조국의 선진화에 기여한다 "
- 창업주 김준기 -

조기석 대표이사 약력(2023년 3월~)

- DB하이텍 Foundry사업부장
- DB하이텍 Foundry영업본부장
- DB하이텍 대만/중국지사장
- 서울대학교 금속공학과 석/박사

1997 동부전자 설립
- 비메모리 사업 진출
- 대규모 차입으로 경영난 → 재무구조 개선
- 기술 노하우 축적 및 반도체 전문 경영인 영입

2014 영업이익 흑자 전환
- 사업체질 지속 강화
  - 신공정.제품 개발, CAPA 확대, 원가절감 등

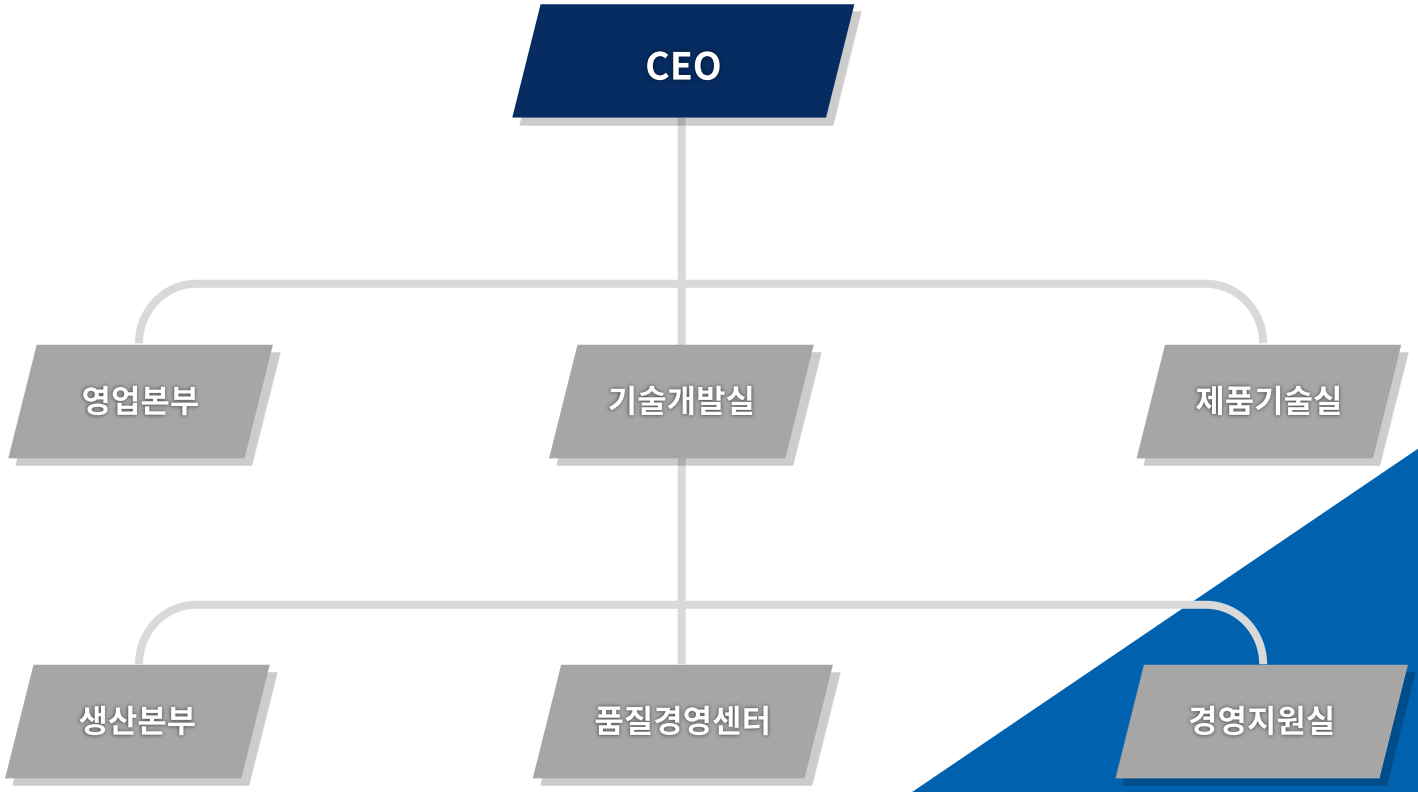
2022 사상최대 매출 및 영업이익

2023 Jump-up 성장 기반 준비
- 조기석 대표이사 취임
- DB글로벌칩(설계부문) 분사
- 고부가 및 차세대 전력반도체 집중 육성

인원	8인치	Tech Node	매출
2,051명	154천장/월	90nm~0.35um	11,312억원

※ 2024.12.31 기준

조직 구성



· 부천캠퍼스(Fab1)

· 상우캠퍼스(Fab2)

제조
(생산직 등)

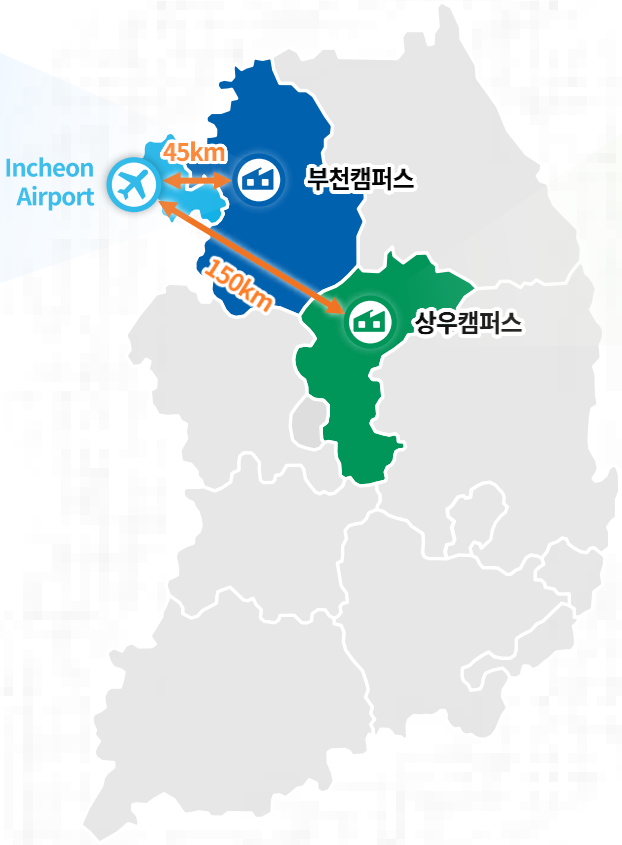
연구개발

영업/마케팅

Staff

생산 시설

Fab1 부천캠퍼스



Fab2 상우캠퍼스

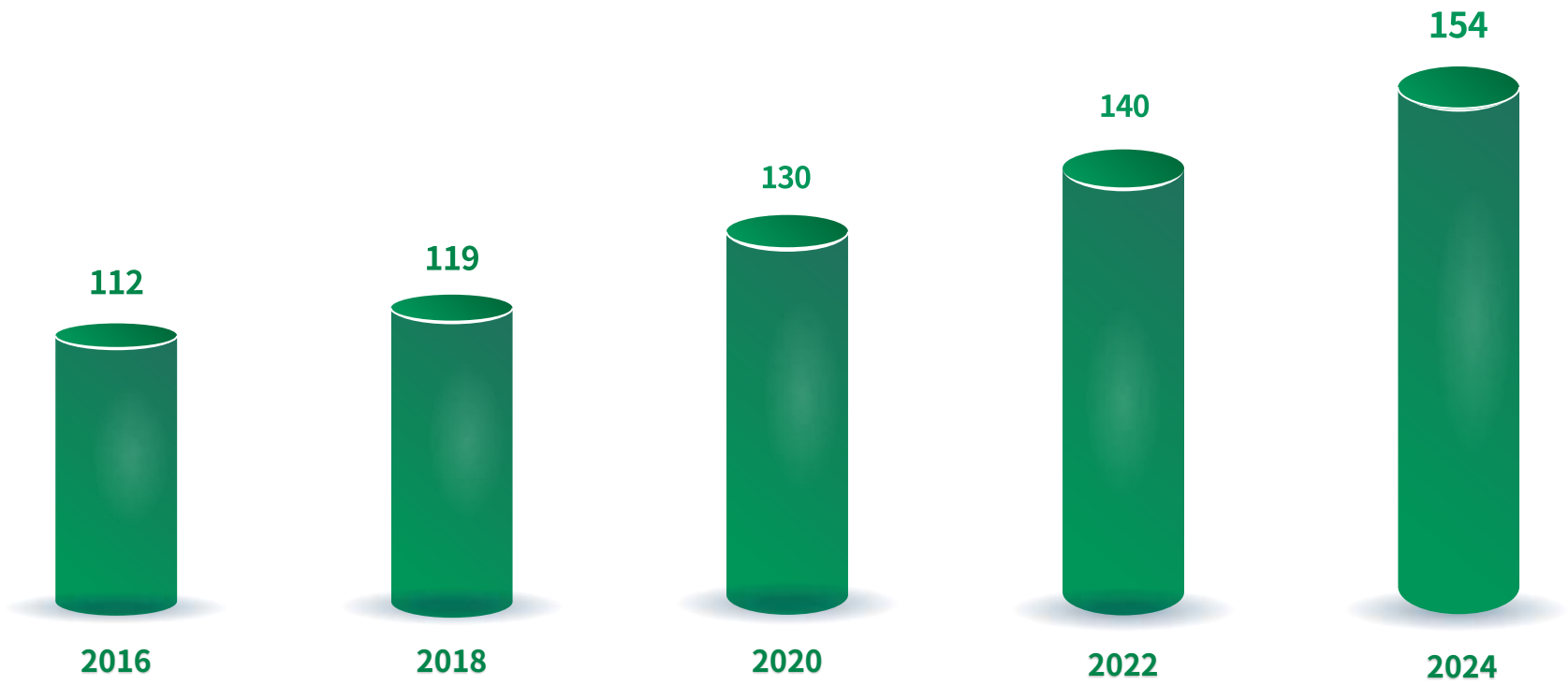
Tech Node	~ 0.15um
주요 공정	BCDMOS, SJ MOSFET, IGBT, Mixed-Signal, DDI
위치	경기도 부천시

Tech Node	~ 0.09um
주요 공정	CIS, Mixed-Signal, BCDMOS, RF, DDI, SiC, GaN
위치	충청북도 음성군 상우리

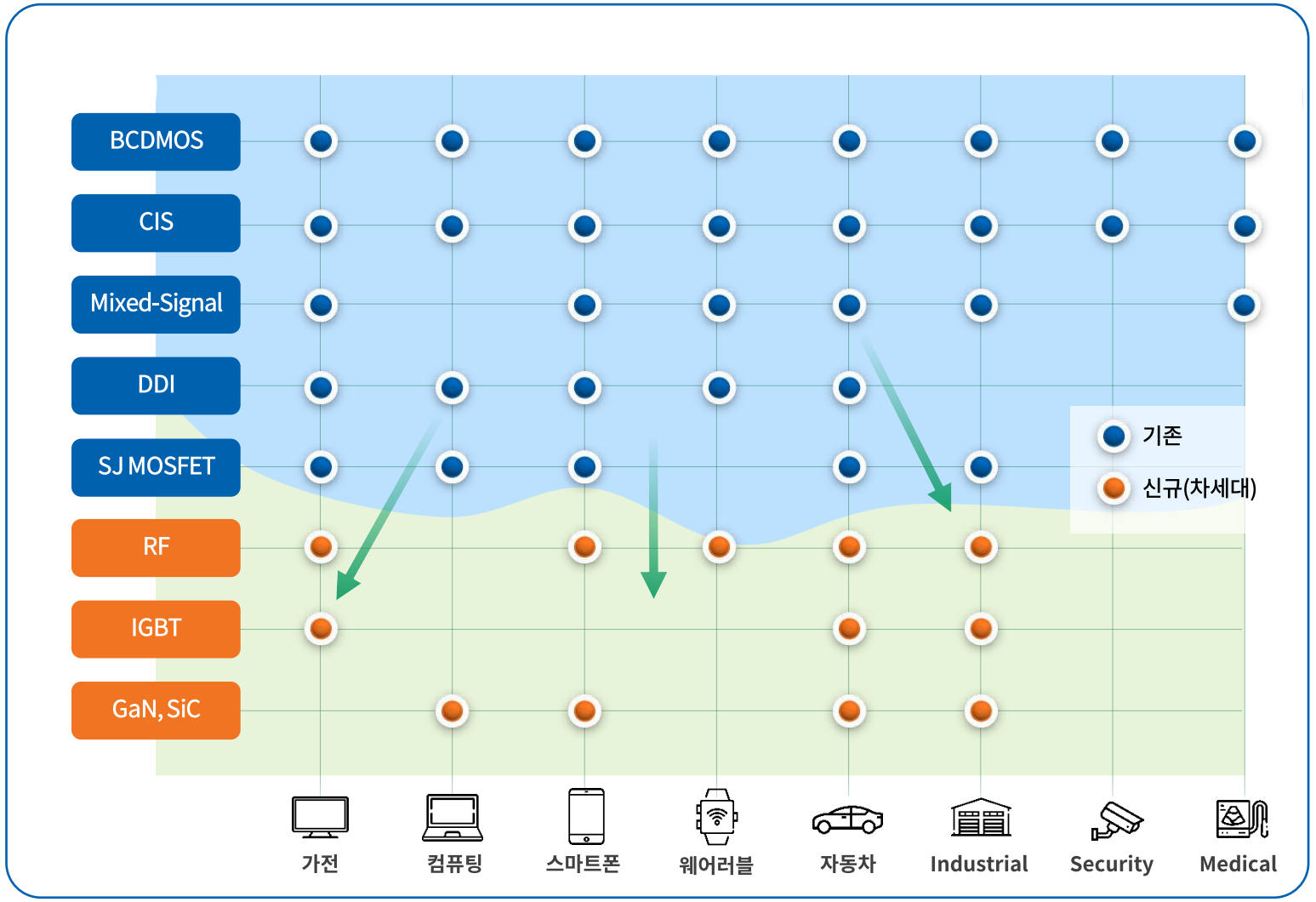
생산 능력

Capacity

(천장/월)



사업 영역


BCDMOS
CIS
Mixed-Signal
DDI
SJ MOSFET
RF
IGBT
GaN, SiC
기존
신규(차세대)
가전
컴퓨팅
스마트폰
웨어러블
자동차
Industrial
Security
Medical

글로벌 비즈니스

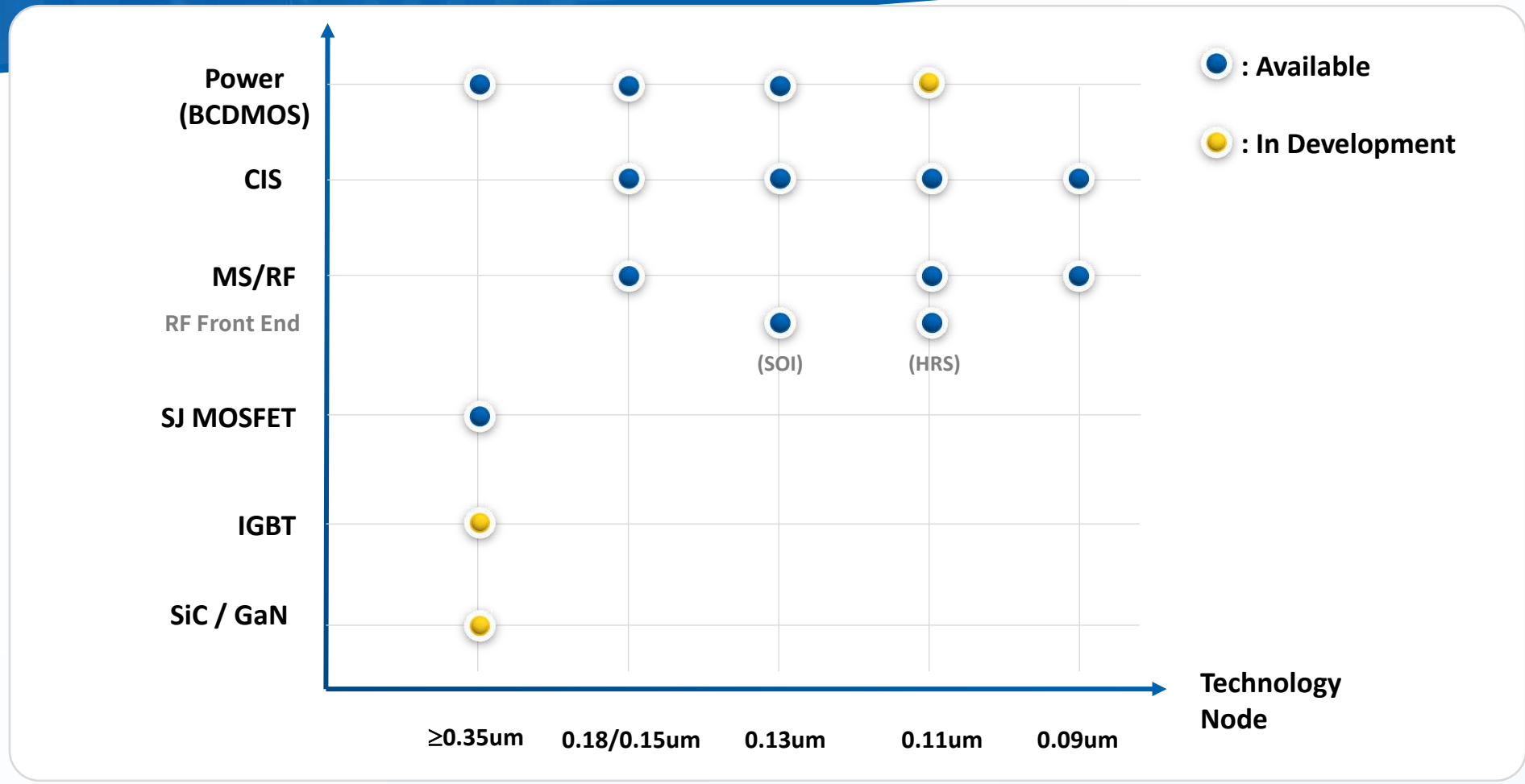
주요 인증


환경안전
ISO 45001
ISO 14001
품질
IATF16949:2016
ISO 9001
정보보안
bsi
ISO/IEC 27001
Information Security Management
CERTIFIED

03

Foundry Business

Platform Technologies



공정기술 로드맵 (Power)

DB HiTek

● Development ● Planning

Process		Available Technology			2025	2026	2027
Power (BCDMOS)	(≤45V)	AN180 (Non-EPI)	AN180_7V	AN180_Gen2 (Non-EPI)	BD180LVB (Gen3)		
		BD180HP (Non-EPI) Low noise	BD180LVA(Gen2)		BD110LV33 (Vgs 3.3V)		
		BD180BH	BD180MV	BD130LVA(Gen2)		90nm BCD	
	(≤120V)	BD180XH (w/, w/o DTI)	BD130XH (w/, w/o DTI	BD180XA	BD130XA		
						SOI BCD	
	(≤900V)	UHV700_Gen2 (Non-EPI)	UHV900 (EPI)		UHV1200 (EPI)		
VDMOS integrated					VD180LV	VD180HV	
Power (Discrete)	SJ MOSFET	Gen2 500V/600V/650V/ 700V/800V/900V/950V		Gen3 300V/600V/650V/700V		Gen3.5 600V/650V	Gen4
	IGBT SiC GaN				IGBT 1200V, Automotive	SiC 1200V Planar MOSFET	SiC 1200V Trench
					GaN HEMT 650V	GaN IC 100/200V	GaN HEMT 650V D-mode Automotive

공정기술 로드맵 (CIS)

DB HiTek

● Development ● Planning

Process		Available Technology			2025	2026	2027
CIS	0.18um	IS18SH					
	110nm ~90nm (FSI/BSI)	IL11SJ (FSI)	IB11SJ (BSI)	ToF : PPD (Consumer)	IL11SA / IB11SA (1.5V/5V)		
		IL09SA (FSI)	IB09SA (BSI)	SPAD G2.1 PDE 14% @900nm (LiDAR, AR/VR)	SPAD G3.1 PDE 25% @940nm (LiDAR, AR/VR)		
				SPAD G3.0 PDE 15% @940nm (LiDAR, AR/VR)		Ge SWIR	
		Global Shutter (Charge Domain, 6T / 7T)			Voltage Domain G/S		

공정기술 로드맵 (MS/RF)

● Development ● Planning

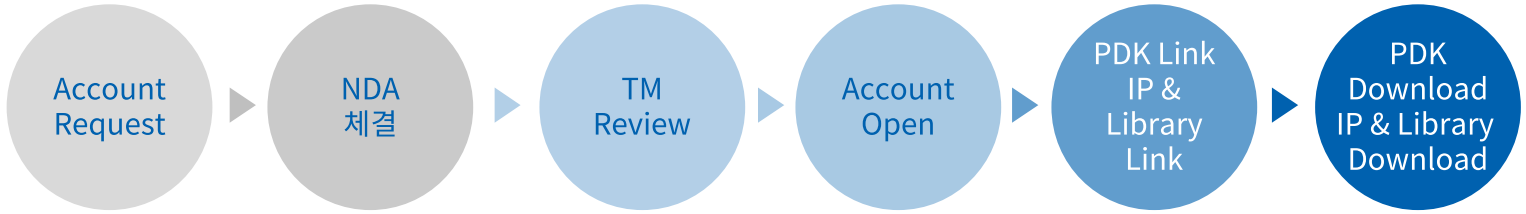
Process		Available Technology			2025	2026	2027
MS/RF	0.11um	TS11SB Low noise	TS11SC Low noise/ULL	RF11SB(Bulk) Low noise			
	0.11um HRS	RH11SA FOM : 134fs Ftpeak : 150GHz					RF GaN
	0.13um SOI	RS13SC FOM : 93fs Ftpeak : 120GHz	RS13SE FOM : 84fs @3.3V Ftpeak : 150GHz		RS13SF 1.2V/2.5V/5V 5V LDMOS		
	90nm	TS09SA Low noise					

*FOM : Ron*Coff

YourFab Service

YourFab LOGIN

YourFab Service Flow



Order To Shipping Service Flow

Stage	PO	Tape Out/ Mask	Wafer Input	Production	WAT	Shipping
YourFab Report	• Order Summary		• Wafer Input Status	• WIP Status • Lot Search	• PCM Summary Report	• Shipping Status

ShuttleChip Service (2025)

● Tape-out start date

FAB	Tech	Application	1Q			2Q			3Q			4Q		
			Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
FAB1 or FAB2	0.18um	Analog /BCD (AN07/AN180/HP180 BD180LV/BD180MV BD180XH/BD180XA)	22	26	26	30	28	25	30	27	24	29	26	
		Analog /BCD (AN180/BD180LV BD180XH/BD180XA)	22		26		28		30		24		26	
FAB1	0.18um	BCD (VD180LV)						04						
	0.15um	Analog/BCD (BEOL0.15um BD18LVA/ AN180 Gen2)	15		12		14		16		10		12	
FAB2	0.13um	Analog /BCD/ SOI (BD130/RS13)		12		02		11		13		15		10
	0.11um	Mixed Signal/ RF HRS	15				14				10			

※ It should be booked one month earlier in YourFab

감사합니다

THANK YOU

DB HiTek World Leader In Specialty Foundry